

# Infineon จับมือ Qualcomm ใช้เซ็นเซอร์ 3 มิติ พัฒนาดีไซน์ต้นแบบ รองรับการยืนยันตัวตนบนอุปกรณ์มือถือ



Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) ร่วมมือกับ Qualcomm Technologies, Inc. เพื่อพัฒนาดีไซน์ต้นแบบ (Reference Design) สำหรับชิปยืนยันตัวตนแบบ 3D บนระบบปฏิบัติการ Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 865 Mobile Platform ซึ่งเป็นการขยายรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 3 มิติสำหรับอุปกรณ์มือถือของ Infineon โดยดีไซน์ต้นแบบดังกล่าวใช้เซ็นเซอร์ REAL3(TM) 3D Time-of-Flight (ToF) และช่วยให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสามารถรวมดีไซน์ที่เป็นมาตรฐานนี้เข้าไปในอุปกรณ์มือถือได้อย่างสะดวกและคุ้มค่า เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 3D ToF ของ Infineon ได้รับการยอมรับจากผลงานความสำเร็จตลอด 4 ปีในตลาดอุปกรณ์มือถือ โดยล่าสุดที่งาน CES 2020 ในลาสเวกัส บริษัทได้เปิดตัวเซ็นเซอร์ภาพ 3 มิติที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก (4.4 mm x 5.1 mm) แต่ทรงประสิทธิภาพด้วยความละเอียดแบบ VGA เซ็นเซอร์ขนาดจิ๋วนี้สามารถตอบรับกับข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดสำหรับระบบการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า การยกระดับพีเอเจอร์การถ่ายภาพ และการสร้างประสบการณ์ที่สมจริงของเทคโนโลยี Augmented Reality

Businessman using using face recognition outdoors

“ปัจจุบันนี้ สมาร์ทโฟนเป็นมากกว่าแค่สื่อกลางในการสื่อสาร โดยมีบทบาทมากขึ้นในด้านความปลอดภัยและความ

บันเทิง” Andreas Urschitz ประธานแผนก Power Management & Multimarket กล่าว “เซ็นเซอร์ภาพ 3 มิติ ทำให้เกิดการใช้งานรูปแบบใหม่ ๆ และการต่อยอดแอปพลิเคชันต่าง ๆ อาทิ การยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย หรือการชำระเงินด้วยระบบจดจำใบหน้า เรายังคงให้ความสนใจกับตลาดนี้ และวางเป้าหมายการเติบโตที่ชัดเจน ความร่วมมือกับ Qualcomm Technologies ในการใช้เซ็นเซอร์ REAL3 เพื่อพัฒนาดีไซน์ต้นแบบนั้น ยืนยันศักยภาพดังกล่าวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเน้นย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในเรื่องนี้” ทั้งนี้ Infineon พัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 3D ToF ด้วยความร่วมมือกับบริษัท pmdtechnologies AG ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และระบบ time-of-flight แบบ 3 มิติ

เซ็นเซอร์ 3 มิติกับการใช้งานรูปแบบใหม่ในสมาร์ทโฟน 5G

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป เซ็นเซอร์ REAL3 ToF ของ Infineon จะทำให้สามารถใช้โบเก้ (bokeh) กับวิดีโอได้เป็นครั้งแรกในสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G เพื่อให้เอฟเฟกต์ภาพที่ดีที่สุดแม้ในภาพเคลื่อนไหว ด้วยการใช้ อัลกอริทึมแบบ 3D point cloud ที่แม่นยำ ข้อมูลรูปภาพ 3 มิติจะถูกประมวลผลสำหรับการใช้งานดังกล่าว โดย เซ็นเซอร์รูปภาพ 3 มิติจะจับแสงอินฟราเรดขนาด 940 nm ที่สะท้อนมาจากผู้ใช้และวัตถุที่ถูกลบออก รวมทั้งจะใช้ การประมวลผลข้อมูลระดับสูงเพื่อการวัดความลึกที่แม่นยำ เทคโนโลยี SBI (Suppression of Background Illumination) ที่จดสิทธิบัตรแล้ว มีช่วงไดนามิกกว้างจึงใช้ได้กับทุกสภาพแสง ตั้งแต่แสงแดดจ้าไปจนถึงห้องที่มีแสงไฟสลัว เทคโนโลยีนี้จึงรับประกันความสมบูรณ์โดยที่ไม่ลดทอนคุณภาพในการประมวลผลข้อมูล

เกี่ยวกับ Infineon

Infineon Technologies AG คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นวัตกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทคือกุญแจสำคัญสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม ในปีงบประมาณ 2562 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน) บริษัทมียอดขาย 8.0 พันล้านยูโร และมีพนักงานราว 41,400 คนทั่วโลก Infineon จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต (ชื่อย่อหุ้น: IFX) และจดทะเบียนในตลาด OTCQX International Premier ในสหรัฐอเมริกา (ชื่อย่อหุ้น: IFNNY)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.infineon.com/real3>

อ่านข่าวนี้ได้ทางออนไลน์ที่ [www.infineon.com/press](http://www.infineon.com/press)

ติดตามเราได้ทาง: Twitter - Facebook - LinkedIn

Qualcomm และ Snapdragon เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Qualcomm Incorporated ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ

Qualcomm Snapdragon เป็นผลิตภัณฑ์ของ Qualcomm Technologies, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ

เกี่ยวกับ pmdtechnologies ag

pmdtechnologies ag เป็นบริษัทวงจรรวม (fabless ic company) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองซีเกน เดรสเดน และอุล์ม และมีบริษัทย่อยในสหรัฐ จีน และเกาหลี บริษัทจำหน่ายเทคโนโลยีภาพดิจิทัลที่ใช้เซ็นเซอร์ 3D Time-of-Flight CMOS ทั่วโลก โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2545 บริษัทเป็นเจ้าของสิทธิบัตรทั่วโลกกว่า 350 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยี pmd และหลักการวัดแบบ pmd โดยตลาดที่ใช้เซ็นเซอร์ 3 มิติของ pmd ได้แก่ ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ยานยนต์ และตลาดคอนซูมเมอร์ อาทิ สมาร์ทโฟน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [pmdtec.com](http://pmdtec.com)

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20200305/2739690-1>

คำบรรยายภาพ: Infineon พัฒนาดีไซน์ต้นแบบร่วมกับ Qualcomm โดยใช้เซ็นเซอร์ REAL3(TM) 3D Time-of-Flight (ToF) มุ่งช่วยผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรวมดีไซน์ที่เป็นมาตรฐานไว้ในอุปกรณ์มือถือได้อย่างสะดวกและคุ้มค่า

โลโก้ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190619/2502113-1-LOGO>